



H6682

有机硅三防涂层胶

H6682 是一种有机硅共形覆膜涂层材料，满足电子工业的最新绝缘，防护要求。本产品对 PCB 板附着力优良，韧性强，耐外力冲击，不易破裂。

具备优异的电绝缘性能，良好的耐高低温性（-60~200℃）耐老化，抗紫外线，防潮，防尘，防有害气体，性能优良。应用于印刷电路板和各种电路元件上，常温固化后在线路板上形成一层保护膜，为电子元器件提供最佳的环境保护。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	有机硅
外观	透明或半透明
组分	单组分
固化方式	室温/加热固化
典型的产品应用	汽车电子，工业自动控制系统，通讯系统，仪器仪表等电子系统的绝缘防护

产品优点

- 涂层具有弹性，应力小
- 化学稳定性强，具备优秀的抗盐雾，防潮防湿性能
- 操作性好，易浸涂，刷涂，喷涂（氮气保护下）
- 快速成膜，对元器件无腐蚀
- 固化后附着力好
- 符合 RoHS 环保认证

产品性能

项目	特征值	备注
固化前		
密度 g/cm ³	0.85±0.05	GB/T13477.2
表干时间 min	10-20	GB/T13477.5
粘度 mpa.s	150-200	GB/T 2794 20rpm
固化后 （23℃ / 50% RH 7天）		



硬度	ShoreA	10-20	GB/T 531.1
抗拉强度	MPa	1.2	GB/T 528
体积电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	1.5×10^{15}	GB/T 1692
击穿电压	kV/mm	≥ 18	GB/T 1693
介电常数	100Hz	2,7	GB/T 1693

使用工艺

1. 清洁表面：物体的表面清理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
2. 表面预烘烤：清洗后 PCB 板最好在 80°C 预烘烤 1min，确保完全去除清洗剂与水份。
3. 涂覆：根据工艺要求，可选择喷涂或刷涂，涂层厚度为 35~50 微米最佳，操作时应该注意环境排气通风，注意产品包装密封。
4. 固化：室温（23°C）固化时，表干时间为 10-20min,完全固化为 24 小时，加温（60-80°C）可以加快固化速度，涂层厚度在 40-50 微米时，在 7-10 天后性能达到最佳。

注意事项

操作时，确保本产品不要在空气中裸露太久，如果使用过程中发现材料慢慢变稠，可添加我司专备稀释性调节粘度，作业环境严禁烟火，操作人员需接受正规化学品安全应用培训，佩戴安全手套，护目镜等。

标准包装

- 5L/罐，10L/罐
- 其它客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：8-25°C，存储期 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。



注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com